酸化物パワー半導体結晶性薄膜の作製

塩尻大士,三橋雅彦,安井学,黒内正仁,金子智(電子技術部電子材料グループ)

1. はじめに

ワイドギャップ半導体は高耐電圧性や紫外・可視光領域 での高い透過性を兼ね備え、パワーデバイスや透明導電膜、 発光素子として実用化がなされてきた.過去数十年間、 GaN や SiC などの 3 eV 程度のバンドギャップ(E_g)幅を もつ材料を中心として基礎学理から実装に至るまで研究 が進められてきたが、近年、より高性能な電子デバイスの 実現のため、4 eV を超える E_g 幅を持つ半導体についての 研究が国内外を問わず国策的・競争的に進められている.

酸化ガリウム (Ga₂O₃) は、 E_g 幅が 4 eV を超えるワイド ギャップ半導体として注目されている. Ga₂O₃の結晶多形 のうち,熱力学的に最安定な単斜晶 β -Ga₂O₃ では,結晶 欠陥低減について原理上有利な β -Ga₂O₃ 単結晶ウェハ上 へのホモエピタキシャル成長だけでなく、 α -Al₂O₃ 基板上 でのヘテロエピタキシャル成長についても盛んに研究が なされてきた.現段階の技術的興味は、結晶学的に高品質 で原子レベルで平滑な β -Ga₂O₃ 薄膜の成膜スループット の向上にある.成膜スループットの向上には、作製条件の 低温化や大面積化、非真空化が肝要であり、実用化に際し て無毒、低毒性なプロセス開発は欠かすことができない.

熱力学的に安定な β-Ga2O3 薄膜は各種薄膜プロセスに より,最低でも 400℃以上で作製されてきた.その薄膜 表面の微細構造構築はデバイス応用上で重要だが,低毒性 かつ 300℃を下回る低温プロセスの報告は少ない.上記の 課題解決には,従来から採用されてきた気相成長法による 成膜条件の最適化や大型化の他、結晶性薄膜作製に関わる 新規プロセス開拓に関わる基礎研究が求められる.

ガラス基板上へ成膜した非晶質 Si へとレーザーを走査 することでガラス基板への熱的影響を最小限にしつつ, Si のみ溶融を行い選択的に結晶化する技術である エキシマレーザーアニーリング (ELA) は大面積で高速な ガラス上の poly-Si 薄膜トランジスタの製造に使用され, 20 年以上前から国内外を問わず盛んに研究なされてきた. しかし,単結晶基板上でのエピタキシャル結晶成長へ適用 した報告については著者が知る限り少ない.特に、Eg幅が 5 eV 程度やそれ以上の深紫外光領域に対応した半導体 エピタキシャル薄膜作製に関わる報告はなされていない.

本資料では,著者らが開発した ELA 手法による β-Ga₂O₃ エピタキシャル薄膜の作製技術^[1,2]の概要について述べる.

実験及び結果

前駆体非晶質 Ga₂O₃ 薄膜作製にはパルスレーザー堆積 (PLD) 法を採用した.β-Ga₂O₃ 焼結体表面へレーザーを 集光照射し,対向に位置する α-Al₂O₃ (0001)基板上へ薄膜 を作製した.基板温度は室温 (~20℃) 非加熱条件とした. 装置アライメントは図1に,成膜条件について表1に示す.



図1:PLD 成膜装置.

表1:前駆体非晶質 Ga2O3 薄膜の成膜条件.

| Substrate | stepped α-Al ₂ O ₃ (0001) plane |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Target | sintered pellet of and β -Ga ₂ O ₃ |
| Temperature | room temperature (not heated, ~20 °C) |
| Ambience | 1.0×10 ⁻⁵ Torr O ₂ |
| | basal pressure: ~5×10 ⁻⁹ Torr |
| Laser repetition | 5 Hz (20 nsec., KrF excimer laser) |
| Laser fluence | ~1.5 J/cm ² |
| Film thickness | ~70 nm |

KrF (λ =248 nm) エキシマレーザーは光子エネルギー が大きく, Si のみならず E_g が 3 eV を超える材料へも適用 が可能であり,表2の条件で前駆体薄膜へELAを行った.

表2:前駆体非晶質 Ga2O3 薄膜への ELA 条件.

| Laser | Non-focused or focused KrF excimer laser $(\lambda = 248 \text{ nm}: 5 \text{ eV}, 20 \text{ nsec.})$ |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beam size | 10×10 mm ² |
| Laser fluence | 100–250 mJ/cm ² |
| Temperature | room temperature |
| Ambience | in air |

ELA の結果,過去の Si などを対象とした数多くの報告 と同様に薄膜は一軸優先配向成長した.図2に ELA 後の 薄膜表面形状を示す.面内結晶方位はランダムであり, 結晶粒界に起因して表面形状に荒れ(凹凸)も生じた.



図2: ELA 後の β-Ga₂O₃ 薄膜表面形状.面内でランダムな結晶成長となり、粒界により表面形状に荒れが生じた.

そこで本研究では基板薄膜間の格子ミスマッチの減少 と,界面でのエキシマレーザー吸収のための酸化ニッケル (NiO)緩衝層を導入した.NiO 緩衝層は室温条件で α-Al₂O₃基板への室温エピタキシャル成長が可能である.^[3] 酸化ニッケル薄膜の紫外-可視波長における光吸収係数α と基板薄膜間の格子定数差を各々,図3と図4に示す.



図3:酸化ニッケルと非晶質酸化ガリウムの光吸収係数.



図4: α-Al₂O₃ 基板とNiO, β-Ga₂O₃間の格子定数差.

2 nm の NiO 緩衝層を導入した結果, ELA 後には図 5(a) に示す原子サイズに拮抗する超平滑な表面が得られた. また,図 5(b)の XRD 回折パターンが示すように、ELA により結晶化した薄膜は面内・面直方位とも基板単結晶 に対して特定の配向性を有しておりβ-Ga₂O₃エピタキシ ャル薄膜が得られたことが明らかとなった.本研究は, 非晶質の前駆体薄膜までは真空プロセスで作製し,ELA は大気中で実施をした全室温環境プロセスである.



図 5: NiO 緩衝層を導入した ELA 後の(a) 薄膜表面形状と (b) β-Ga₂O₃ 薄膜のエピタキシャル成長を示す X 線回折像.

3. 今後の展開

超平滑で結晶学的に高配向な β-Ga₂O₃ エピタキシャル 薄膜を ELA 法により全室温環境で作製した.現在,上記 結晶成長技術を応用・拡張した技術について下記特許申請 をしている.今後は実用化に資する大面積・高速・低温な ウルトラワイドギャップ半導体作製プロセスを構築する.

(筆頭発明者としての特許申請①) 特願 2024-152696.

(筆頭発明者としての特許申請②)特願 2024-152686.

(Accepted) D. Shiojiri, *et al.*, "Surface patterning of wide-gap semiconducting β -Ga₂O₃ thin films by area selective crystallization via room-temperature excimer laser annealing and low toxic wetetching processes," *Applied Physics Express* (2024).

Reference

- D. Shiojiri, *et al.*, "Room-temperature laser annealing for solid-phase epitaxial crystallization of β-Ga₂O₃ thin films," *Applied Physics Express* 9 (2016) 105502-1–105502-(DOI : https://doi.org/10.7567/APEX.9.105502)
- [2] D. Shiojiri, *et al.*, "Room-temperature fabrication of highly oriented β-Ga₂O₃ thin films by excimer laser annealing," *Journal of Crystal Growth* 424 (2015) 38–41.
 (DOI: https://doi.org/10.1016/j.jcrysgro.2015.04.026)
- [3] Y. Kakehi, *et al.*, "Room-temperature epitaxial growth of NiO(1 1 1) thin films by pulsed laser deposition," *Journal of Crystal Growth* 237–239 (2002) 591–595.